

MEMORIAL DESCRITIVO – DISCO DFM2800

1. INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Função: Realizar a montagem de Wafers de $\Phi 300\text{mm}$ de diâmetro em fr ames metálicos

Modelo: DFM2800

Fabricante: DISCO Corporation

2. FOTO DO EQUIPAMENTO



DGP8761

3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

A DFM2800 é uma máquina montadora de wafers de silício especializado para integração em um sistema em linha com sistema de afinamento, para processar wafers ultrafinos de $\Phi 300$ mm. Ele monta wafers que foram desbastadas com o sistema DGP8761 em fitas de corte com frames e remove a fita de proteção da área ativa de forma estável. Também é compatível com a aplicação de DAF (Fita de anexação de unidades) com fita integrada, necessária para a fabricação de SiP (Sistema em pacote) de próxima geração.

Para atender aos requisitos de afinamento de wafers de $\Phi 300$ mm com espessura inferior a $25\text{ }\mu\text{m}$, o risco de quebra de wafers ultrafinos é minimizado pela redução do número de etapas de manuseio do wafer para apenas 20% em relação ao modelo existente.

Além disso, um mecanismo de limpeza foi instalado em cada plataforma/mesa de manuseio para evitar a quebra do wafer causada pela intrusão de partículas.



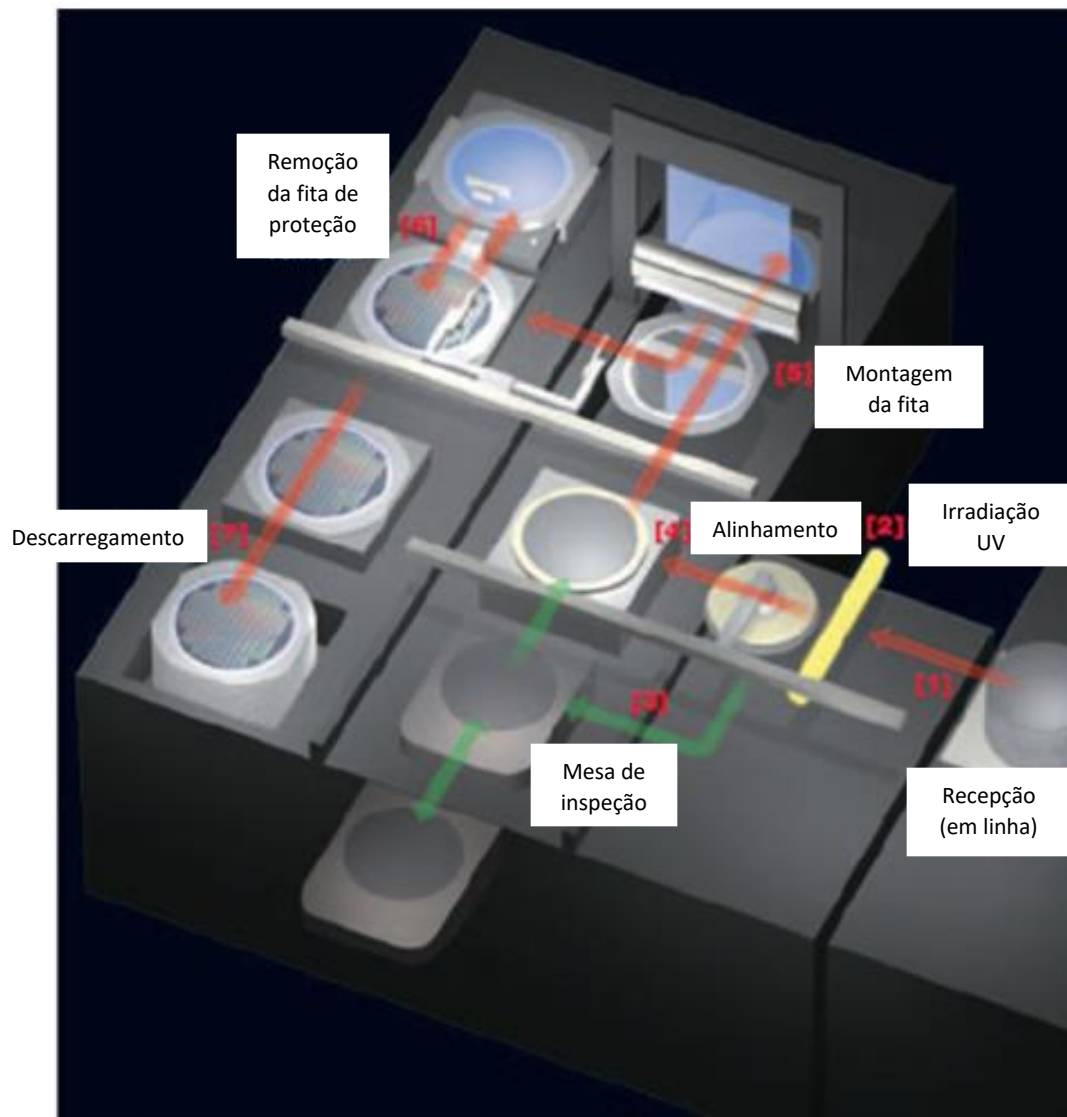
DFM2800



**Imagem meramente ilustrativa*

Para evitar qualquer perigo para os operadores, intertravamentos de hardware são instalados em locais inerentemente perigosos, impossibilitando a abertura do equipamento durante processamento.

Seguem abaixo as seções e sistemas embarcados no equipamento:



1. Recepção do wafer da unidade de lixamento;
2. Irradiação UV na fita de proteção frontal da peça (quando a fita UV é utilizada);
3. Transferência da peça para a mesa de inspeção (quando a inspeção é necessária);
4. Alinhamento usando processamento de imagem;
5. Montagem da peça com fita de corte ou fita DAF 2 em 1;
6. Remoção da fita de proteção da área ativa da peça;
7. Armazenamento do frame com fita (com o wafer montado) no cassete.

4. ESPECIFICAÇÕES

Especificação	Unidade	Dado
Tamanho de peça suportado	mm	Φ200 / Φ300
Precisão de fixação do wafer e direção X/Y (montagem em quadro)	mm	+/- 0,5 ou menos
Precisão de fixação do wafer e direção θ (montagem em quadro)	°C	+/- 0,5 ou menos
Precisão de fixação da fita de corte e direção X/Y	mm	+/- 1 ou menos
Dimensões do equipamento (L×P×A)	mm	2150 x 2643 x 1800
Peso do equipamento	kg	Aprox. 3100